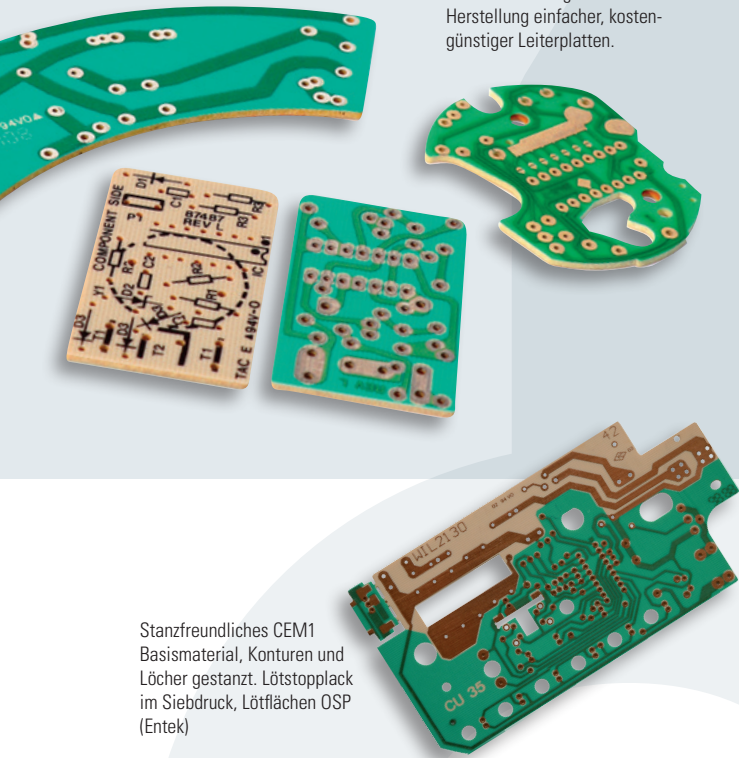


Einseitige Leiterplatten – die Allrounder.

Good to know!

Einseitig kupferkaschiertes Basismaterial eignet sich zur Herstellung einfacher, kostengünstiger Leiterplatten. Verschiedene Materiallösungen erlauben optimierte Produktionsprozesse, das Ergebnis ist ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis. Im Grossmengenbereich ist das helle Basismaterial CEM1 ein hervorragender Kompromiss: Kostengünstiges Basismaterial verbunden mit ausgezeichneter Stanzbarkeit ergeben eine preisgünstige Lösung Ihrer Schaltung.

Einseitig kupferkaschiertes Basismaterial eignet sich zur Herstellung einfacher, kostengünstiger Leiterplatten.



Stanzfreundliches CEM1 Basismaterial, Konturen und Löcher gestanzt. Lötstopplack im Siebdruck, Lötflächen OSP (Entek)

CEM1 Basismaterial im 2er Nutzen, **Push-back Technologie** (Konturen gestanzt und in den Nutzen zurückgedrückt). Löcher ebenfalls gestanzt, Lötstopplack, Pads in Hot Air Levelling

FR4 erfüllt auch erhöhte Anforderungen: Kleinste Bohrungen bis 0.1 mm, die Konturen können gefräst oder gestanzt werden sowie die Verfügbarkeit verschiedenster Materialstärken von 0.2 mm bis 8.0 mm ergeben ein breites Anwendungsspektrum im industriellen Bereich.

Produktqualität mit neuester Technologie

Technische Zuverlässigkeit verstehen wir als Fundament unseres Angebotes. Aufgrund der erfolgreichen Entwicklung von innovativen Systemen steht unseren Kunden ein umfangreiches Produktportfolio zur Verfügung, das sich durch lange Lebensdauer und höchste Funktionalität auszeichnet. Einseitige Leiterplatten sind die klassischen und ältesten Produkte auf dem Leiterplattenmarkt. Das bedeutet aber nicht, dass die Anforderungen an die Präzision und Qualität solcher Platinen gering sind.

ICOM bietet auch in diesem Produktbereich ein breites Spektrum an Leiterstrukturen von Mikroelektronik bis zu Dickkupferstrukturen für Hochleistungselektronik. Neben vielfältigen Leiterstrukturen ist die mechanische Bearbeitung der Leiterplatte, von kontrollierter Tiefenfräsung und Tiefenbohrungen über Kerbfräsungen und Perforationsbohrungen bis hin zu hochpräzisen Steckkontakten, eine weitere Schlüsselkompetenz von ICOM.

Einseitige Leiterplatten

Einseitige Leiterplatten werden mit 1-Lagen Kupfer versehen und sind ohne durchkontaktierte Bohrungen. Sie werden wie alle Leiterplatten im fototechnischen Prozess hergestellt. Standardmässig erhalten die Leiterplatten einen einseitigen Lötstopplack, der ebenfalls fototechnisch strukturiert wird. Optional kann ein Bestückungsdruck auf einer oder auf beiden Seiten aufgebracht werden. Wählen können Sie auch die Leiterplattendicke (0.2 – 8.0 mm) und die Kupferstärke (18 – 400 μ) sowie verschiedene Oberflächen wie HAL-bleifrei, chem. SN, chem. Ni/Au, Carbon, und galv. Ni/Au. Die Kontur kann gestanzt, geritzt oder gefräst werden.



ICOM Industrial Components AG
Bramenstrasse 5
CH-8184 Bachenbülach
Tel. +41 44 861 02 02
www.icompcb.ch

Einseitige Leiterplatten

Features	Capabilities
Layers	1 Layer
Laminate Thickness	FR4, High Tg FR4, Halogen free FR4, CEM1 (paper-glass composite material) Aluminium
Copper thickness	12/18/35/70/105 µm up to 400 µm
Approval	UL-approval, Flame class 94 V-0
Specialized laminate	Taconic, Rogers, Neltec, Arlon, further specialized material Nelco, Panasonic
max. Boardsize	max. 610 x 910 mm (überlange Leiterplatten bis 1500 mm)
Surface finish	Hot air leveling, (Lead or Lead-free) Bondgold immersion Silver Hardgold for Connectors immersion Tin chem. Au/Ni (immersion gold over nickel) Silver ink or Carbon ink OSP (Entek)
Soldermask	Liquid, photoimageable Soldermask in green or as requested, Peelable Mask
Component marking	White or per request
Outlines	CNC V-Scoring CNC Milling Precision Punching
min. Drill Diameter	0.10 mm
General tolerances	min. Outline tolerances routed +/-0.050 mm min. Outline tolerances punched +/-0.050 mm min. Holesize diameter +/-0.050 mm min. Hole position tolerance +/-0.050 mm min. Pattern Registration tolerance +/-0.050 mm min. Soldermask Registration tolerance +/-0.050 mm
General Capabilities	min. Annular ring 0.050 mm min. Soldermask bridge 0.080 mm plated Gold thickness 0.025 µm – 3 µm immersion gold thickness 0.025 µm – 0.6 µm Twist and Wrap < 1 % E/Test Voltage 24 V – 300 V Continuity 5 – 100 Ohms Flying Probe test available